

Detektieren von Microvias mit suboptimaler Anbindung



Microvias zur elektrischen Verbindung der Lagen in Leiterplatten machen bei HDI-PCBs hohe Anschlussdichte möglich. Suboptimale Bodenanklebung, die zu Felddelaminationen führt, kann mit Temperaturwechsel- (TWT) und Interconnect Stress Test (IST) entdeckt werden. Im Allgemeinen sind Microvias sehr zuverlässige Strukturen, da sie sich meist nur von einer Lage zur nächsten erstrecken und somit der mechanische Stress aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung von Basismaterial und Kupfer vergleichsweise gering ausfällt. Dennoch können natürlich auch Microvias aufgrund thermischer Belastungen ausfallen, wobei der bekannteste Ausfallmechanismus das Abreißen der Microvias vom Lochboden ist. Dieser Effekt tritt verstärkt bei ‚stacked‘ Microvias auf, ist jedoch auch bei anderen Aufbauten detektierbar. In der Schlifffanalyse erscheint dieses Fehlerbild als dünne, zum Teil schwer erkennbare Trennlinie, die sich bei näherer Untersuchung, z. B. mittels FIB, als Separation herausstellt.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)